

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

## 沪士电子股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2025-0506-009

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 √其他： <u>网络会议</u>
参与单位名称 及人员姓名	CITIGROUP、Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company、ARROWPOINT INVESTMENT PARTNERS、Lombard Odier DH Asia、Pinpoint Asset Management Ltd、Citigroup Internal、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、Cathay Life Insurance、Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、T Rowe Price、Goldman Sachs Asset Management、Sumitomo Mitsui Trust Bank、Invesco Asia、Barings LLC、POLYMER CAPITAL MANAGEMENT、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、DE Shaw、Pinpoint Asset Management Ltd  (本次会议由CITIGROUP组织，采取网络会议形式，参会者均未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。)
时间	2025年5月6日 15:00-16:00
地点 (会议方式)	网络会议
公司接待 人员姓名	钱元君
投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司收入结构  答：2024年应用于AI驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施等领域的企业通讯市场板实现营业收入约100.93亿元，其中AI服务器和HPC

相关 PCB 产品约占 29.48%；高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品约占 38.56%；其余主要是通用服务器、无线基础设施这些。

2024 年公司汽车板整体实现营业收入约 24.08 亿元，其中公司毫米波雷达、采用 HDI 的自动驾驶辅助以及智能座舱域控制器、埋陶瓷、厚铜、P<sup>2</sup>Pa ck 等新兴汽车板产品约占 37.68%。

## 2、高复杂度高多层板全球供应格局。

答：AI 驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计 2025 年下半年产能将得到有效改善。公司近两年的资本开支，相信大家从现金流量，在建工程等财务数据里也可以情绪的看到。2025 年第一季度财报现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约 6.58 亿。

## 3、泰国工厂。

答：公司正在全员攻坚，推动沪士泰国生产基地从试生产到量产，并尽快达到预期的生产效率和产品质量，形成规模化量产能力，争取在 2025 年第二季度全面加速开启客户认证与产品导入工作，逐步释放产能，并进一步验证中高端产品的生产能力，为逐步提高产品梯次打好基础，为未来的市场竞争做好准备。同时借助精细化成本管控手段，以有效控制初期成本；搭建全方位风险预警与应对机制以应对海外工厂建设运营风险，夯稳实现经营性盈利目标的桩基。

## 4、800G 交换机市场情况。

答：这个在我们 2024 年报中也多次提及，2024 年下半年，高速网络的交换机及其配套路由相关 PCB 产品是公司增长最快的细分领域，环比增长超 90%。AI 的快速发展也驱动数据中心交换机市场的深刻变革。传统上，数据中心交换机支出主要用于连接通用服务器的前端网络，然而人工智能与高性能计算集群的连接需要一个数据中心规模的架构，即人工智能后端网络，同时前端网络也需要额外的容量来支持后端部署，调研机构 Dell'Oro Group 近期发布的报告预测，以太网数据中心交换机销售在未来五年（2025-2029 年）或超 1,800 亿美元。目前来看 800G 交换机市场需求还是不错的。

	<p><b>5、汽车板市场情况</b></p> <p><b>答：</b>汽车 PCB 市场处在中低端供给过剩、价格竞争、原材料价格波动、技术研发压力等复杂的环境中，呈现出规模增长、竞争加剧、需求结构变化、技术创新加速等特征。智能化成为市场重要趋势，车企加快推动智能化迭代升级，L2 级辅助驾驶逐步普及，城市导航辅助驾驶落地加速，并将智驾下放到更低价位车型。技术创新将持续引领汽车 PCB 市场发展，需求结构也将不断变化，随着市场竞争的加剧，行业内中低端供给过剩的产能或将经历清理和优化调整。公司密切关注市场需求变化，依托深耕多年的通讯设备、汽车电子领域底层技术积累和创新能力以及在客户端长期累积的安全、稳定、可靠的产品质量信誉，与客户在新能源车三电系统，自动驾驶辅助，智能座舱，车联网等方面深度合作，加快新技术的研发投入，开展关键技术的研发，深度参与客户前期设计及验证，紧跟汽车行业的发展趋势，提升技术能力和适用性，增强与客户在技术上的准确支持以及在业务上的长期合作，逐步调整优化产品和产能结构，以应对市场挑战。</p> <p><b>6、在复杂的外部环境下，公司整体的经营策略。</b></p> <p><b>答：</b>公司向来注重中长期的可持续利益，而非仅仅局限于眼前的短期利益。在公司产品主要面向的应用领域，公司始终坚持面向整体市场的主要头部客户群体开展业务，大家去看我们 2023 年、2024 年定期报告中披露的前五大客户，在 2024 年收入同比实现不错成长的同时，公司还是努力保持行业头部客户的均衡。</p> <p>公司深知只有着眼长远，动态适配市场中长期的需求结构，保持客户均衡，才能在不断变化的市场环境中稳健发展，实现可持续增长。公司需要准确把握未来的产品与技术方向，在超高密度集成、超高速信号传输等方面持续加大技术和创新方面的资源投入，通过技术创新、均衡的多元化客户结构、供应链韧性及区域布局。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 6 日